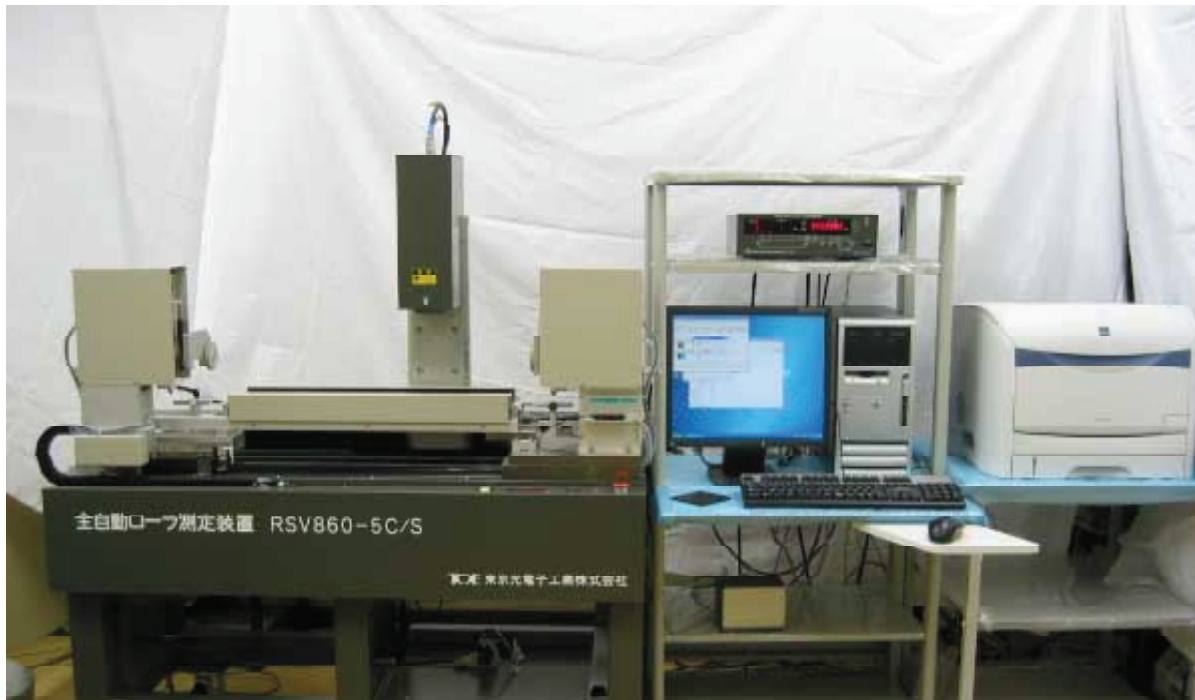


品質管理、研究開発専用機

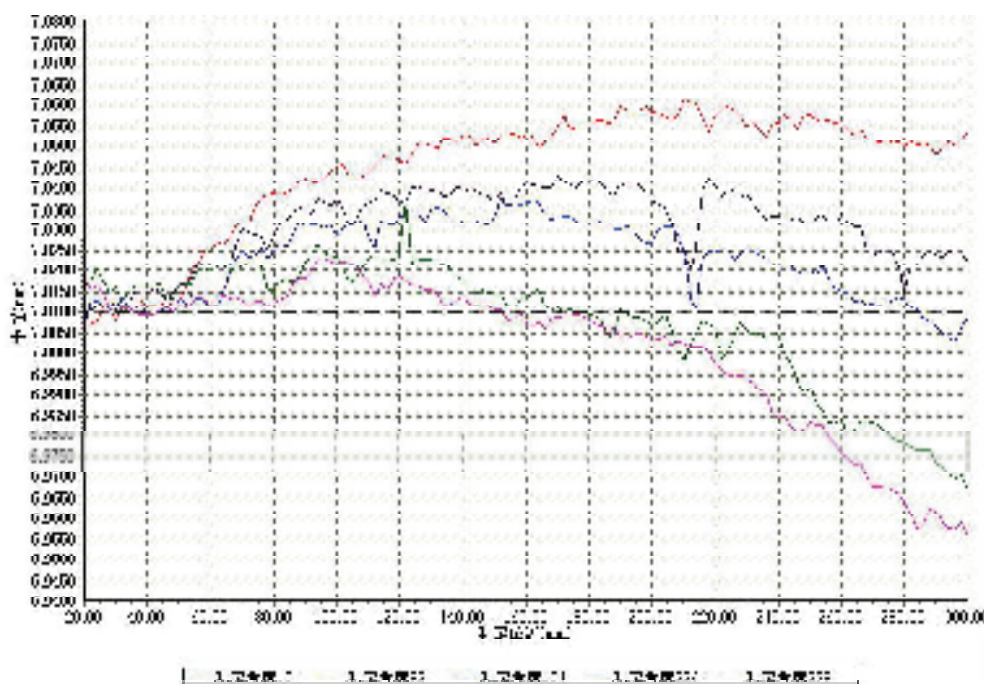
測定最小表示値 0.0001mm
軸方向 0.05mm ピッチ
最小回転角度 0.1° 毎

高精度型 全自動ローラ測定装置



測定部 : レーザマイクロゲージ LMG800PⅢ
測定範囲 : 外径最大 $\phi 2 \sim 70\text{mm}$ (SUS製円筒ストレートエッジ2本搭載の為)
測定項目 : 標準測定-外径、振れ、円筒度、真円度、クラウン、外径差、
特殊測定-長手優先、回転優先 (各外径測定、形状測定)
3次元形状表示 (Micro AVSに出力)
ステージ : 移動方向 精密研削ボールネジ、LMガイド、ACサーボモータ
回転方向 カムフォロア (エアシリンダ駆動ワーク押さえ付)、
サーボモータ、回転原点用円盤付
省スペース型センサ部移動方式を採用
真直度測定用円筒ストレートエッジ (ステンレス製)
ワーク搭載部間隔自動移動 (モータ駆動、規格ファイルにて動作)
コントロール部 : DOS/V機 OS : Windows-XP ドライブ基板内蔵
出力部 : カラーA4レーザプリンタ
ラック部 : コントロールPC、LMG表示部、レーザプリンタ搭載用ラック
校正証明書 : ローラ測定装置としての校正証明書を発行いたします。

高精度型測定プログラムで各種測定に対応致します。
お客様の特殊測定条件により新規プログラムの追加も可能です。



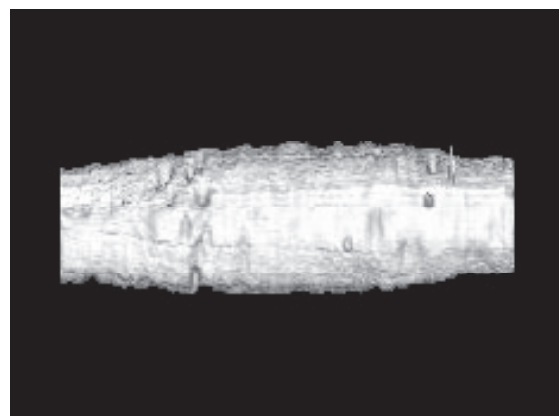
長手方向プロフィールグラフ

高精度測定を可能にするための特別仕様を集結致しました。

- 1 レーザマイクロゲージは高精度型のLMG800PⅢモデルを搭載
- 2 軸方向送り最小50 μ mピッチ(標準測定では600点まで)
- 3 回転方向 ϕ 10mm以上0.1°ピッチ、 ϕ 5~ ϕ 10未満時最小0.5°ピッチ(マーク付円盤、ビームファイバーセンサ使用時)
- 4 特殊測定ソフトによる高精度な外径測定、形状測定を実現
- 5 測定したデータを3次元形状ソフトMicroAVSに出力し容易に表示、印刷可能



(着脱式マーク付円盤)



(3次元形状表示ソフト Micro AVS
により測定結果の凹凸を100倍に
拡大した3次元形状表示例。)

TOE 東京光電子工業株式会社

〒178-0065 東京都練馬区西大泉6-5-8

営業部 TEL 03-3922-9598 FAX 03-3922-9595

E-mail:sales@toe.co.jp URL:http://www.toe.co.jp